

# MEMS



CSMicrosensor(Ningbo)Technology Co.,Ltd.

## 启微数感

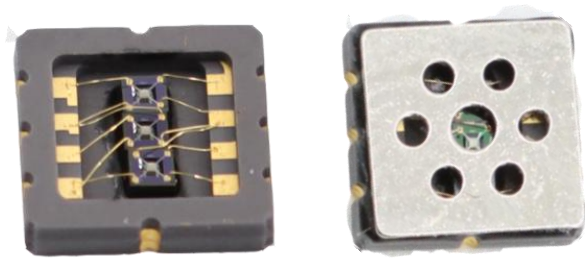
### DFN 陶瓷封装

### DFN Ceramic Packaging

## 一、封装类型：

标准：DFN 陶瓷封装

封装材料：陶瓷



## 二、封装尺寸和外形：

外形尺寸：长 5 \* 宽 5 \* 高 1.04（单位：毫米）

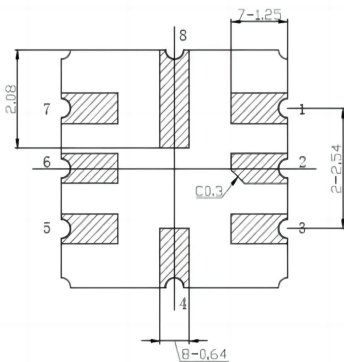
引脚数量：8

引脚排列：标准引脚排列（请参考模块结构图纸）

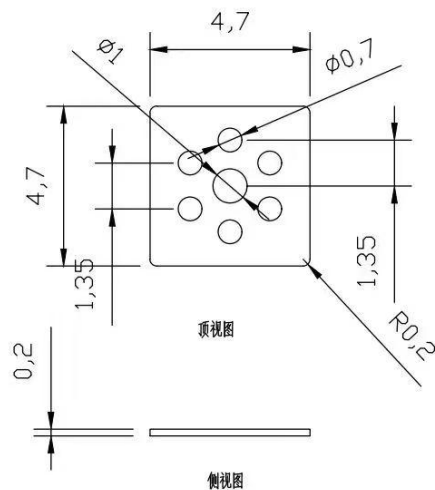
## 三、使用注意事项：

安装和焊接时，请遵循相关的制造商建议和标准操作规程；避免封装受到机械应力或冲击；封装应存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体环境中，避免长时间暴露在高温、高湿度环境中；注意防止封装受到静电放电（ESD）的影响，采取适当的防护措施。

## 四、模块结构：

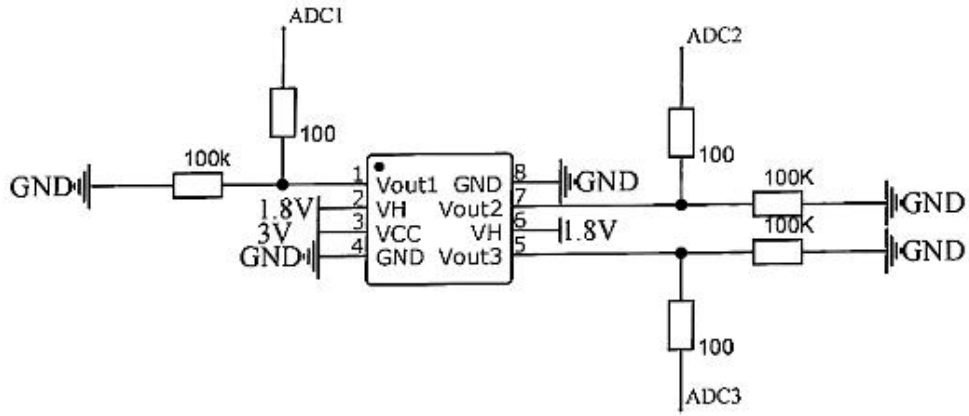


底视引脚布置图



外形图

五、典型应用电路：



注：此为内部绑 3 颗 MEMS 微热板的推荐应用电路。

推荐管脚定义		
序号	名称	定义
1	Vout1	传感器电极 (-)
2	VH	加热正极 (+1.8v)
3	VCC	传感器电极 (+3v)
4	GND	加热负极 (-)
5	Vout3	传感器电极 (-)
6	VH	加热正极 (+1.8v)
7	Vout2	传感器电极 (-)
8	GND	加热负极 (-)